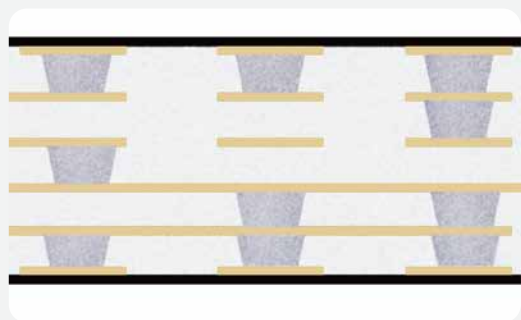


合金型導電銅膏

半導體相關應用基板，高信賴性多層基板

用途

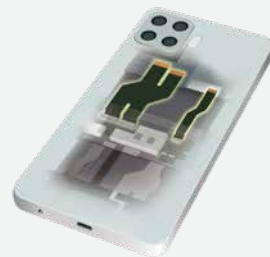
層和層連接導通



高速通訊基板層間的導通連結

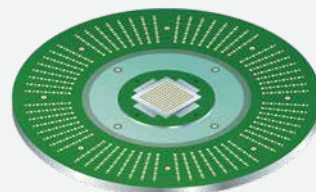
民生用品

圖：智慧型手機高速通訊基板



半導體測試用基板

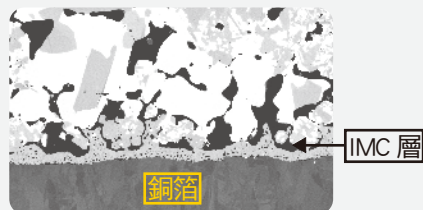
圖：Probecard



特性

何謂合金型銅膏

應用高熔點和低熔點的金屬混合而成的導電膏
加熱後高熔點和低熔點以及銅箔之間則會形成 IMC 合金。
具有高安定性和信賴性的材料。



- 合金形銅膏可以有效和銅箔形成 IMC 層，藉此提高更安定的連結導通性。
- 具有高耐熱，高散熱之特性
- 藉由填孔熱壓來取代傳統通孔電鍍製程，並達成高密度線路設計。

產品型錄和特性表

產品型號			MP8300	MPA500	MPA510	MPA550
黏度	BH型	dPa·s	1,400 ~ 2,200	1,000 ~ 2,000	900 ~ 1,700	1,200 ~ 2,000
固化條件			180°C × 60分			
體積阻抗率		$\Omega \cdot \text{cm}$	8.00E-05	1.50E-04	2.00E-04	8.00E-05
熱傳導係數 (Laser flash method)		$\text{W/m} \cdot \text{k}$	25	12		20
玻璃轉化溫度		°C	151	147		

